

OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen RJ45C3 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Produktsortiment umfasst stehende und liegende Ausführungen sowie Versionen mit den Rasthaken oben und unten.

- THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
- Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierte LED´s und Schirm-Kontaktfahnen
- Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis $+85\text{ °C}$
- Verstärkte Goldschicht für verbesserten

Korrosionsschutz

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gbit/s

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RJ45C3 S1V 2.7N4N RL
Best.-Nr.	1433900000
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, SMD-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, Gold über Nickel, schwarz, Tape (Ø 330 mm); $R_s = 10^9 - 10^{12}\ \Omega$
GTIN (EAN)	4050118238587
VPE	300 Stück
Verpackung	Tape (Ø 330 mm); $R_s = 10^9 - 10^{12}\ \Omega$

OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen RJ45C3 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3,467 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	> 500 MΩ	Nennspannung	125 V AC
Nennstrom	1,5 A	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V DC

Systemkennwerte

Abgangswinkel	180°	Anschlussart	Buchse
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Beschaltung	8-adrig
Kategorie	Cat.3	LED	Nein
Lötstiftlänge (l)	3,5 mm	Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss
Polzahl	8	Produktfamilie	OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen
Raster in Zoll (P)	0,05 inch	Raster in mm (P)	1,27 mm
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Kupferlegierung
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750
Verpackung	Tape (Ø 330 mm); Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 9T	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	II
CTI	≥ 500	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Phosphor-Bronze	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schichtaufbau - Steckkontakt	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

**OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen
RJ45C3 S1V 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Downloads**

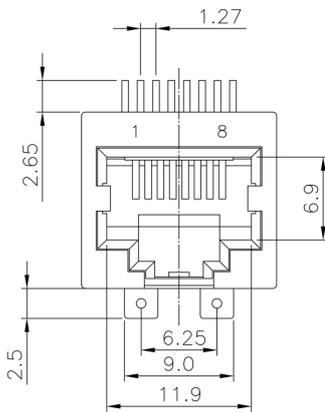
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen
RJ45C3 S1V 2.7N4N RL**

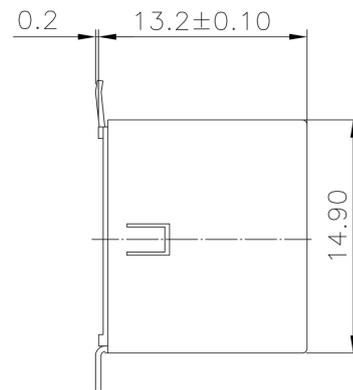
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

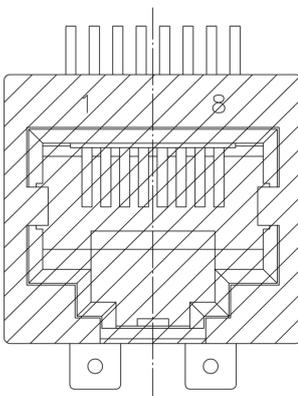
Maßzeichnung



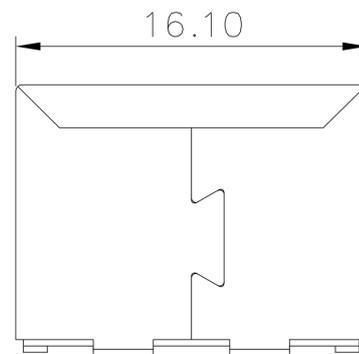
Maßzeichnung



Maßzeichnung

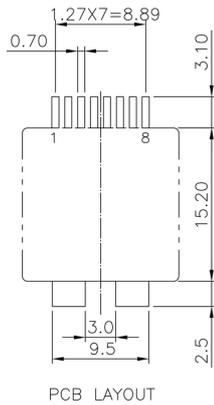


Maßzeichnung



**OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen
RJ45C3 S1V 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

OMNIMATE Data - RJ45 Buchsen
RJ45C3 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

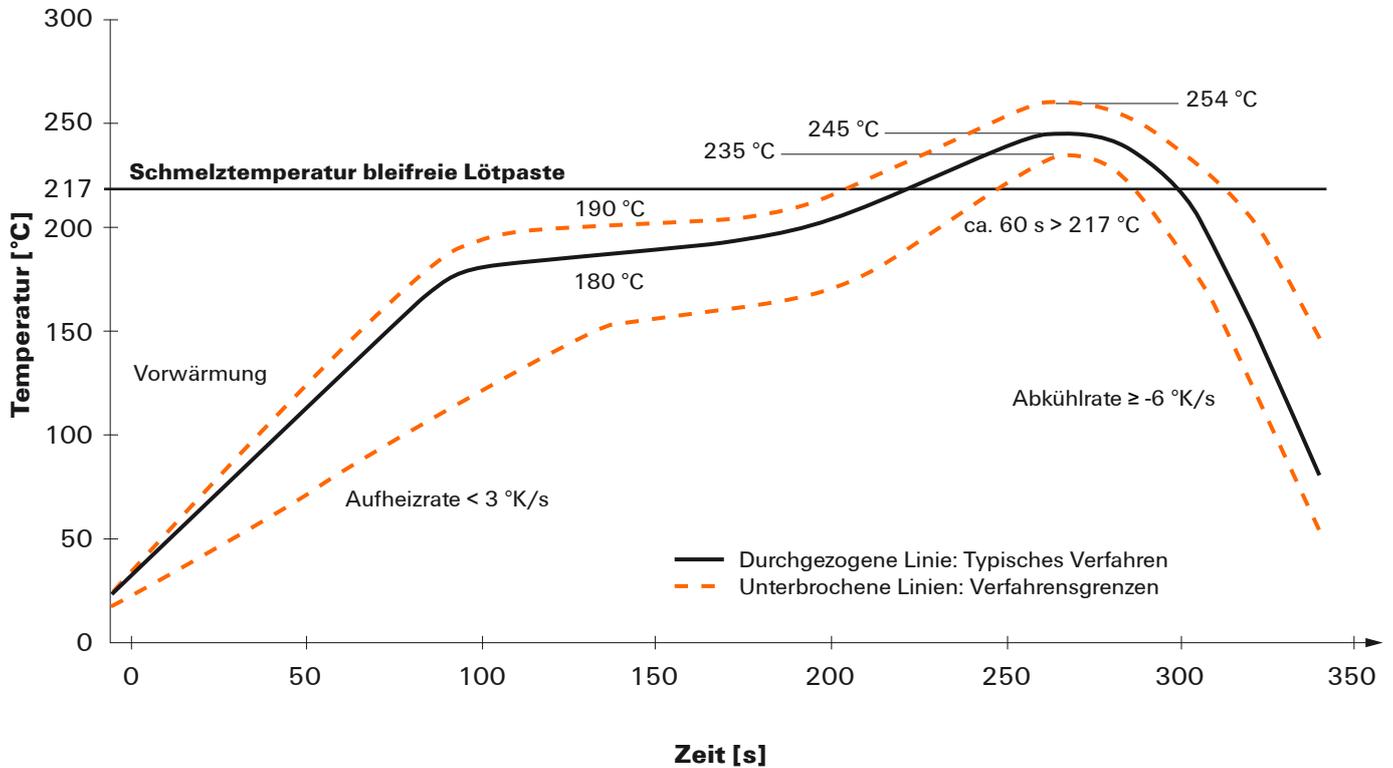
Zeichnungen

Legende

Code	Value	Description
RJ45	G1	RJ45
R1	R	Through Hole Reflow - THR
U	U	Unshielded
3.2	3.2	3.2 mm
E	E	with EMI tabs
4	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
GY/GY	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
TY	TY	Tray in box (manual assembly)
	RL	Tape on Reel (automated assembly)
	Y/G	Yellow/Green
	G/Y	Green/Yellow (standard)
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
	O/G	Orange/Green
	R/O	Red/Orange
 (further combinations possible)
	N	without LED
	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
	E	E = with EMI tabs
	N	N = without EMI tabs
	3.2	3.2 mm
	1.6	1.6 mm
	D	SMD
	U	Horizontal (90°, side entry), latch up
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down
	V	Vertical (180°, top entry)
	Y	Diagonal (45°), latch up
	1	1 Port
	12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport
	21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel
	R	Through Hole Reflow - THR
	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering
	T	Soldering process: Reflow soldering
	...	Through Hole Technology - THT
	...	Soldering process: Wave
	C5	Category 5
	C6	Category 6
	C6A	Category 6A
	C5e	Category 5e
	M	10/100 Mbit
	G1	10/100/1000 Mbit
	G10	10 Gbit
	U	Unshielded
	MP	10/100 Mbit with POE
	MP+	10/100 Mbit with POE+

Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3 \text{ K/s}$. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei $\geq -6 \text{ K/s}$ härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.